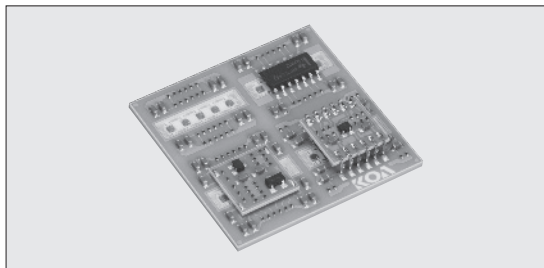
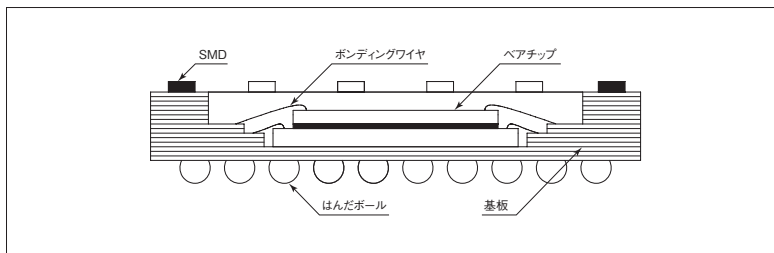


## KLCJ■カスタムモジュール



■構造図



■特長

- 複数の半導体を1パッケージ組み込むことによるシステムの小型化、高機能化、標準化
- LTCC基板の多層フィンパターンによる配線面積の低減、配線距離の短縮による信号遅延問題の解消
- 外部端子削減による実装不良の低減

■実装仕様

項目	単位	minimum	Standard	Maximum	Note
基板外形寸法	mm	—	—	100×100	
基板厚み	mm	0.4	—	2.0	
ベアチップパッドピッチ	μm	100	—	—	
ベアチップパッドサイズ	μm	70	—	—	
ベアチップ厚さ	mm	0.1	0.2	—	
封止高さ	mm	0.3	1.0	1.2	チップ表面からの高さ
ワイヤー長さ	mm	0.3	—	3.0	
ループ高さ	μm	100	200	—	
ワイヤー径	Au μm	20	25	40	
基板表面処理	無電解金めっき				
基板	・LTCC				

■パッケージ仕様

項目	内容
端子ピッチ	0.8mm～
搭載可能部品	・SMD ・ベアチップ ・印刷抵抗
対応可能パッケージ	・SON ・BGA ・LGA
パッケージ基材	・LTCC

セラミック基板、パッケージモジュール